证券代码: 300656 证券代码: 民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-02

投资者关系活动 类别	特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	□其他
参与单位名称	东兴证券、国海证券、深圳德明资本、广州晶诚资管	
时间	2024年3月14日	
地点	线下策略会、公司会议室	
上市公司接待 人员姓名	证券事务代表: 陈国兵	
_		

1、晶圆代工厂广芯微电子项目的量产进度如何?

答:广芯微电子项目自 2023 年 12 月份开始批量生产,目前的主要产品包括:沟槽式肖特基二极管,45-200V 全系列产品已开始批量生产,广微集成已向广芯微电子下达超过 3,000 片的采购订单,后续广微集成将根据广芯微电子产能及市场情况持续下单;特高压 DMOS 系列产品,工艺复杂、难度较大的 1,500V 特高压 DMOS 已开始批量生产,900V-1200V 系列产品正在工程批流片验证;高压 BCD 产品工程批流片中,争取二季度批量出货。预计到今年 6 月,广芯微电子可实现月产能 1 万片,年底月产能达到 3 万片以上。

投资者关系活动 主要内容介绍

2、公司为什么会选择在今年控股广芯微电子?

答:公司选择在目前这个时点控股收购广芯微电子,主要考虑是:广芯微电子已于 2023 年 12 月开始量产,从建设阶段正式迈入量产爬坡阶段,整个项目最大的不确定因素已经消除,后续主要是持续开发产品、扩大产能,其未来的成长确定性相对较高,所以公司决定将晶圆代工厂这个核心资产纳入上市公司,增强上市公司对核心战略资产的掌控力度。公司计划收购丽水高质量发展基金和丽水绿色产业基金分别持有的广芯微电子部分股权,全部交易完成后,公司将持有广芯微电子 50.1%的股权,此次交易预计会在 2024 年年底前完成。

3、芯微泰克项目进展情况如何?

答:超薄背道代工厂芯微泰克项目于 2023 年 12 月 27 日实现通线投产,目前已有十多家客户在芯微泰克进行 IGBT、SGT、特种功率及 IC 等产品的背道工艺试样验证,按计划 3 月份开始逐步进入批量生产;预计到今年 6 月份芯微泰克月度投产的订单数量将达到 5,000 片规模,今年年底实现月产出 1.5-2 万片的水平。芯微泰克一期产能建设为6 英寸晶圆 4 万片/月、8 英寸晶圆 1.5 万片/月,今年的主要经营目标是到四季度实现单月度的经营性现金正流入,并计划在下半年开放对外融资,为后续二期扩产做准备。

4、公司条码业务未来增长的方向都有哪些?

答:公司已将条码识别业务战略升级为 AiDC(Artificial Intelligence & Data Capture,人工智能&数据采集)事业部,赛道容量得到进一步拓宽;在 AI 模型检测时代,厂商的核心竞争力体现在是否能开发出适合应用场景的 AI 模型,民德电子将依托自身在条码识别领域深厚的技术积累和丰富的行业经验,以 AI+CIS 机器视觉技术平台,为汽车产业、3C、生物医疗检测设备等先进制造业提供条码识读、OCR、器件颜色、尺寸、形状等各种数据采集解决方案的生产性服务。公司近期推出了针对医疗检验设备领域的新产品,后续也将重点关注汽车制造、3C 精密电子等制造业领域龙头客户的痛点需求,推出具有极致性价比和差异化功能的新产品。未来,公司将会持续进行产品研发和算法迭代优化工作,提升产品在不同应用场景中的领先优势。

附件清单(如有)

一无

日期

2024-03-14